**ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG KONTAKT**

Terry Emerson

[terry.emerson@samtec.com](mailto:terry.emerson@samtec.com)

+1 812-981-8304

**[SAMTEC LOGO] Juni 2018**

**Samtec bringt branchenführenden Randverbinder mit hoher Kontaktdichte im Ultra-Fine-Rastermaß auf den Markt**

Randverbinderbuchse im Mikroraster 0,50 mm für Einsparungen bei Platz und Kosten

**New Albany, Indiana (USA):** Samtec gibt die Einführung der branchenweit ersten Randverbinderbuchse im 0,5-mm-Rastermaß (MEC5) mit Ausgleichsfeder bekannt. Diese Auslegung erfüllt bei optimierten Kosten die Anforderungen in Bezug auf höhere Kompaktheit und Übertragungsgeschwindigkeiten.

Die Ausgleichsfeder der Buchse verschiebt die Karte so, dass sie richtig zu den Kontakten ausgerichtet ist. Dies ermöglicht, die bei Leiterplatten üblichen Toleranzen bei solchen Karten zu verwenden, die sonst nicht mit Steckverbindern im Ultra-Fine-Format funktionieren würden. So können die Fertigungskosten mit 30 bis 50 Prozent Kosteneinsparung bei Leiterplatten und einem hohen Ertrag bei Standardkarten optimiert werden.

Die extrem hohe Kontaktdichte dieser Randverbinderbuchse im Ultra-Fine-Rastermaß 0,5 mm bietet im Vergleich zu den weiter verbreiteten 0,8-mm-Lösungen ungeahnte Platzeinsparungen. Die sowohl in gerader (MEC5-DV) als auch gewinkelter (MEC5-RA) Ausführung erhältliche Buchse überzeugt mit insgesamt bis zu 300 I/Os für Anwendungen mit hoher Dichte.

Um die Forderung der Branche nach höheren Geschwindigkeiten erfüllen zu können, ist die gerade Buchse für 28 Gbit/s NRZ bzw. 56 Gbit/s PAM4 ausgelegt. Beide Ausführungen sind für die Signalübertragung gemäß PCIe® Gen 4 geeignet.

„Ich bin erfreut, die Einführung des MEC5-Randverbindersystems bekanntgeben zu können, da hiermit Samtecs ohnehin schon riesiges Angebot an Randverbindern um eine weitere Lage aufgestockt wird“, sagte Terry Emerson, Manager für den Bereich High-Speed-Produkte bei Samtec. „Die Fähigkeit, bei solch engen Kontaktabständen mit standardmäßigen Leiterplattentoleranzen zu arbeiten, ist momentan in der Branche einzigartig. So können unsere Kunden Signale mit hoher Geschwindigkeit durch einen Steckverbinder mit unglaublicher Kontaktdichte übertragen – und dabei die Kosten für die Leiterplatte als Gegensteckverbinder in vernünftigen Grenzen halten.“

Bei einer Stromtragfähigkeit von 1,5 A pro Kontakt nimmt das System Karten mit einer Dicke von 0,062 Zoll bzw. 1,60 mm auf und ist mit den üblichen Führungsstiften und mechanischen Kartencodierungen ausgestattet. Für den sicheren Anschluss an die Leiterplatte kann zwischen robusten Schweißlaschen in THT- oder SMt-Technik gewählt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der [Webseite mit den Leiterplattenrandverbindersystemen im Mikro-Format von Samtec](https://www.samtec.com/connectors/edge-card/high-speed/micro-edge-card).

Die Bildmarken PCI-SIG®, PCI Express® und PCIe® sind eingetragene Warenzeichen und/oder unregistrierte Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.

**Über Samtec**

Das 1976 gegründete Privatunternehmen Samtec ist ein weltweit agierender und 713 Millionen US-Dollar schwerer Hersteller einer breiten Palette an elektronischen Steckverbindungen. Dazu gehören IC-zu-Board und IC-Packaging, Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board, Hochgeschwindigkeitskabel, Mid-Board- und Panel-Optiken sowie flexibel stapelbare, robuste und Mikro-Bauelemente und -Kabel. In unseren Samtec Technology Centers werden Technologien, Strategien und Produkte entwickelt und weiterentwickelt, um sowohl die Leistung als auch die Kosten eines Systems vom nackten Chip bis zu einer 100 Meter entfernten Schnittstelle zu optimieren – und alle Verbindungspunkte dazwischen. Mit 33 Standorten in 24 verschiedenen Ländern macht die globale Präsenz von Samtec den unerreichten Kundendienst möglich. Weiterführende Informationen finden Sie auf <http://www.samtec.com>.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Telefon: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)